



## mAgic® PE350 用于模块粘接的有压烧结银

PE350是一款专为模块粘接应用而设计的创新型有压烧结材料。PE350具有卓越的导热性和可靠性，不仅适用于芯片粘接，还适用于大面积模块粘接，能够在极低的烧结参数下提供卓越的性能。这是一款无铅产品，且不含卤素和纳米颗粒。

### 主要优势

- 专为模块粘接而优化设计
- 支持印刷和干贴工艺
- 低烧结参数值
  - 烧结温度: 200°C
  - 烧结压力: 12MPa
  - 烧结时间: 5-10分钟

200°C

烧结温度

12 MPa

烧结压力



高可靠性

